

# KB-5252 (ANSI: CEM-1/ Halogen-free)

## 无卤素布、纸组合覆铜基板

### Features 特点

- Halogen-free, Friendly to the environment  
无卤板材，对环境友好
- Excellent punching property, Suitable for punching at 35°C~60°C  
优良的冲孔性，最佳冲孔温度为 35°C~60°C
- Excellent heat and humidity resistance  
良好的耐热性和耐湿性
- Warp and twist are small and stable  
弓曲率、扭曲率小且稳定
- IPC-4101E/15 specification is applicable  
符合 IPC-4101E/15 的规范要求
- KB-5252 CTI≥175V

### Applications 应用领域

- Display  
显示器
- VCR  
录像机
- Power supply  
电源基板
- Industrial Instrument  
工业仪表
- Digital sound recorder, etc  
数码刻录机等

### General Properties 一般特性

Test Item 测试项目	Unit 单位	Test Method (IPC-TM-650) 测试方法	Test Condition 处理条件	Specification (IPC-4101E) 规范值	Typical Value 典型值
<b>Thermal 热性能</b>					
Solder Resistance 耐焊性	Sec	2.4.13.1	Float 260°C/unetched	≥10	25
Z-Axis Expansion Z 轴热膨胀系数	ppm/°C	2.4.24	E-2/105 TMA	---	100/320
	%			---	6.0
Flammability 燃烧性	Rating	UL94	UL-94	V-0	V-0
<b>Electrical 电性能</b>					
Surface Resistivity 表面电阻	MΩ	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1.0×10 <sup>4</sup>	1.0×10 <sup>5</sup>
Volume Resistivity 体积电阻	MΩ-cm	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1.0×10 <sup>6</sup>	1.0×10 <sup>7</sup>
Dielectric Constant 介电常数	—	2.5.5.2	Etched/@1 MHz	≤5.4	4.6
Loss Tangent 介质损耗	—	2.5.5.2	Etched/@1 MHz	≤0.035	0.023
Arc Resistance 耐电弧性	Sec	2.5.1	D-48/50+D-0.5/23	≥60	125
Comparative Tracking Index 相比漏电起痕指数	V	IEC 60112	Etched/0.1% NH <sub>4</sub> CL	≥175	175
<b>Mechanical 机械性能</b>					
Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度	N/mm	2.4.8	125°C	--	1.2-1.4
			Float 260°C / 10 Sec	≥1.05	1.2-1.4
Bow / Twist 弯弓度/翘曲度	%	2.4.22.1	A	≤1.5	0.3/0.4
Flexural Strength 抗弯强度	N/mm <sup>2</sup>	2.4.4	Length direction	≥242	420
			Cross direction	≥172	290
Moisture Absorption 吸水率	%	2.6.2.1	D-24/23	≤0.5	0.15

#### Remarks:

Specimen Thickness: 1.6mm 1 / 0 样品厚度：1.6mm 1 / 0

A = Keep the specimen originally without any process 保持原样,不作处理

C = Temperature and humidity conditioning 在恒温恒湿的空气中处理

D = Immersing in distilled water with temperature control 浸在恒温的水中处理

E = Temperature conditioning 在恒温的空气中处理